

# 大连市半导体行业协会文件

大半协发〔2014〕011号

## 关于组织企业参加软交会专题论坛的通知

各会员单位：

第十二届中国国际软件和信息服务交易会将于2014年6月19日—22日在大连世界博览广场举办。为集中展示大连市集成电路设计产业形象，向参会企业宣传和推介大连集成电路设计企业，经大连市半导体行业协会与组委会沟通，拟在软交会期间召开“集成电路设计与智慧城市建设”专题论坛，现将具体事宜通知如下：

- 1、名称：集成电路设计与智慧城市建设
- 2、主题：合作共赢、创新发展
- 3、主办单位：大连市经济和信息化委员会、大连高新园区管委会
- 4、承办单位：大连市半导体行业协会、辽宁省集成电路设计产业

基地

- 5、日期：2014年6月19日
- 6、时间：9:30—12:00
- 7、地点：大连世界博览广场二层5号会议室
- 8、规模：80人左右
- 9、拟邀请嘉宾：核高基专家、863计划专家
- 10、日程：

序号	时间	内容	报告人
1	9:30-10:10	领导致辞	科技部高技术中心 省经信委 市经信委 高新园区
2	10:10-10:30	大连市智慧城市 总体规划介绍	科技部信息资源整合基地 秘书长 孙立宪
3	10:30-10:50	专题报告	大连高新区设计管理办公室 副主任贾乃雄
4	10:50-11:20	专题报告	中国核高基专家组组长 魏少军
5	11:20-11:40	专题报告	硅展科技副总裁 赖聪敏
6	11:40-12:00	专题报告	爱康普科技董事长 邱运邦
7	12:00	会议结束	

11、专家在连期间，有意向与专家单独约见的集成电路设计企业，请在回执中标明具体时间、企业参加人员及联系方式。

请各单位于6月6日17:00前，将回执表以邮件形式回传至协会秘书处：

联系人：孙颖

邮件：[dlbdtXH@163.com](mailto:dlbdtXH@163.com)

电话：0411-88149076

手机：13019416453

附件：参加论坛回执表



### 参加论坛回执表

公司名称			
联系人		邮箱	
电话		手机	
参加论坛人员名单			
姓名	职务	手机	邮箱
与专家会见情况			
拟约见时间	企业参加人员	职务	联系方式